

证券代码：002579
债券代码：124004
债券代码：124005

证券简称：中京电子
债券简称：中京定转
债券简称：中京定 02

公告编号：2020—017

惠州中京电子科技股份有限公司

2019 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

无

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

是否以公积金转增股本

是 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 2019 年度利润分配股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	中京电子	股票代码	002579
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	余祥斌	黄若蕾	
办公地址	广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号	广东省惠州市仲恺高新区陈江街道中京路1号	
电话	0752-2057992	0752-2057992	
电子信箱	obd@ceepcb.com	huangruolei@ceepcb.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）业务与产品及经营模式

公司主营业务为印制电路板(PCB)的研发、生产、销售与服务,主要产品为刚性电路板(RPCB)、高密度互联板(HDI)、柔性电路板(FPC)、刚柔结合板(R-F)和柔性电路板组件(FPCA)。公司产品结构类型丰富,产品应用领域广泛,是目前国内少数兼具刚柔印制电路板批量生产与较强研发能力的PCB制造商,能够同时满足客户不同产品组合需求、快速响应客户新产品开发,为客户提供产品与技术的一体化解决方案。

近年来,世界经济风云变幻,全球电子信息产业正发生深刻变革,产业格局不断调整变化,产品创新与迭代加速发展,为更好地把握行业发展机遇,快速响应市场需求变化,公司加大了对高多层电路板、高阶HDI及Anylayer HDI、刚柔结合板(R-F)、SLP(m-SAP)等产品的投入与布局,深入切入5G通信、新型高清显示、新能源汽车电子、医疗防疫、人工智能、物联网以及大数据与云计算等新兴市场领域。

公司主要经营模式为以销定产,依据客户订单组织和安排生产,按不同产品特性定制生产工艺,为客户提供个性化综合解决方案。公司的客户主要为下游电子信息产业终端应用领域核心品牌企业。公司在深化与现有客户良好合作的基础上,积极拓展国内外市场,持续提升公司市场占有率。不断丰富产品结构、持续提升产品技术水平以及快速响应市场变化与客户需求的能力是公司PCB产业当前及未来重要的业绩驱动因素。

（二）公司所处行业情况

印制电路板作为电子信息产业的核心基础组件,被誉为“电子工业之母”。PCB行业下游应用领域非常广泛,市场空间广阔,优质的PCB企业发展趋势良好。根据Prismark统计,2018年全球PCB行业产值达到623.96亿美元,同比增长6%。随着国内对5G通信、数据中心、人工智能、新能源充电桩、工业互联网、特高压与智能电网等科技端“新基建”板块的建设进程加快,5G通信、新型高清显示、新能源汽车电子、人工智能、智慧医疗、工业互联网以及大数据与云计算等高附加值、高成长性新兴应用领域将获得蓬勃发展机会,从而推动PCB产业持续稳步增长。

同时,受益于全球PCB产能向中国转移,国内PCB行业产值增速显著高于全球水平。2006年,中国PCB产值超过日本,成为全球第一。但是,由于国内PCB行业发展阶段及PCB产业链较长等特点所致,国内PCB企业数量众多,市场集中度整体较低,同时,近年来受国家环保政策日益趋严、中低端产品市场竞争加剧等因素影响,行业整合趋势加快,PCB企业综合管理难度增加。治理不规范、创新与竞争优势不明显的中小企业则面临较大经营压力,而较具规模经济效应的先进企业通过借助产品、技术、客户、资金、管理及成本等优势,积极响应下游客户与市场变化需求,加快提升产品技术水平及扩大生产规模,将获得快速发展机遇。

（三）公司所处的行业地位

公司专注于印制电路板（PCB）的研发、生产、销售与服务二十年，具备丰富的行业经验与技术积累，系CPCA行业协会副理事长单位，行业标准制定单位之一，系工信部首批符合《印制电路板行业规范条件》的PCB企业、全球印制电路行业百强企业、国家火炬计划高技术企业，拥有省级工程研发中心和企业的技术中心、国家级博士后科研工作站、广东省LED封装印制电路板工程技术研究中心，是全国电子信息行业创新企业、广东省创新型企业，在产业技术与产品质量等方面居国内先进水平。

近年来，公司通过投资建设与产业并购方式，努力夯实PCB主营业务，不断丰富产品结构、稳步提升产销规模，强化成本控制意识和内部运营效率，公司行业竞争力不断增强，根据中国电子电路协会（CPCA）发布的PCB行业年度排名，公司近几年行业影响力及市场占有率得到持续快速提升。

近年来，公司通过投资建设与产业并购方式，努力夯实PCB主营业务，不断丰富产品结构、稳步提升产销规模，强化成本控制意识和内部运营效率，公司行业竞争力不断增强，根据中国电子电路协会（CPCA）发布的PCB行业年度排名，公司近几年行业影响力及市场占有率得到持续快速提升。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入	2,098,774,792.77	1,761,337,240.84	19.16%	1,076,553,203.25
归属于上市公司股东的净利润	148,690,533.54	81,557,970.86	82.31%	23,744,017.70
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	119,361,434.22	70,255,351.56	69.90%	18,943,788.59
经营活动产生的现金流量净额	245,575,190.28	133,486,947.79	83.97%	39,798,307.66
基本每股收益（元/股）	0.400	0.220	81.82%	0.06
稀释每股收益（元/股）	0.400	0.220	81.82%	0.06
加权平均净资产收益率	13.58%	8.07%	5.51%	2.44%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额	3,345,306,557.00	2,789,956,410.45	19.91%	1,660,993,265.07
归属于上市公司股东的净资产	1,340,440,078.16	1,010,469,257.93	32.66%	981,569,305.11

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	456,049,553.99	480,839,664.33	555,015,396.31	606,870,178.14
归属于上市公司股东的净利润	14,175,975.32	41,213,628.84	52,509,877.79	40,791,051.59
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	15,543,754.38	20,180,541.25	46,285,196.24	37,351,942.35
经营活动产生的现金流量净额	32,936,770.94	62,295,876.68	72,973,863.73	77,368,678.93

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

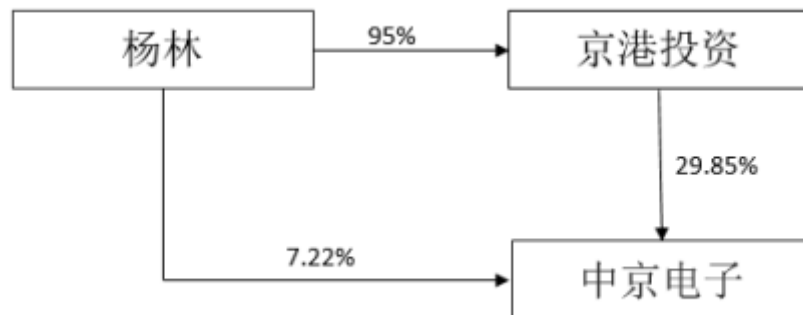
报告期末普通股股东总数	23,860	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	29,871	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
惠州市京港投资发展有限公司	境内非国有法人	29.85%	111,858,462	0	质押	84,129,990	
香港中扬电子科技有限公司	境外法人	19.08%	71,492,613	0	质押	13,000,000	
杨林	境内自然人	7.22%	27,043,832	20,282,874	质押	24,330,000	
中国建设银行股份有限公司一信达澳银新能源产业股票型证券投资基金	其他	0.93%	3,482,101	0			
惠州市普惠投资有限公司	境内非国有法人	0.65%	2,448,310	0			
JPMORGAN CHASE BANK,NATIONAL ASSOCIATION	境外法人	0.51%	1,912,062	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.44%	1,647,200	0			
许树华	境内自然人	0.43%	1,626,600	0			
金鹰	境内自然人	0.36%	1,351,826	0			
华泰证券股份有限公司	国有法人	0.35%	1,317,893	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名股东中，杨林为惠州市京港投资发展有限公司控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	报告期末，惠州市京港投资发展有限公司通过信用证券账户持有公司 20328472 股；惠州市普惠投资有限公司通过信用证券账户持有公司 2448310 股；许树华通过信用证券账户持有公司 1626600 股；金鹰通过信用证券账户持有公司 1351826 股。						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

2019年，宏观经济环境受到中美贸易摩擦和技术争端等因素的深度影响，中国经济发展的不确定性增加，但同时国内5G通信、新型高清显示、新能源汽车电子、工业互联网、人工智能、数据中心与云计算等下游新兴应用领域的蓬勃发展却为PCB行业带来了新的发展机遇，PCB行业发展风险与机遇并存。优质PCB企业，通过整合行业资源，紧抓电子信息产业发展机遇，快速响应市场与客户需求，积极提升行业竞争力和市场地位，预计将获得持续快速发展。

报告期内，公司经营管理团队在董事会领导下，紧密围绕公司发展战略和“改革、创新、高效”的企业精神，继续深化内部管理改革，加强市场开拓，加大新兴应用领域新产品开发和新工艺创新力度，推进公司智能制造与供应链系统优化，实现了企业运营效率持续改善，研发创新能力大幅提升，企业经营业绩持续快速增长。报告期内，公司实现营业总收入20.99亿元，同比增长19.16%；归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，同比增长82.31%。

报告期内，重点工作如下：

（一）完成元盛电子少数股权收购，积极探索使用创新配套融资工具

为进一步发挥公司刚性电路板和柔性电路板在客户开拓、新产品组合、创新技术与工艺联合研发、原材料采购等方面的优势互补与协同效应，增强公司核心竞争力，2019年公司启动并完成了对元盛电子剩余45%股权的收购，元盛电子成为公司全资子公司。同时，为改善公司财务状况、降低财务费用，加快推动FPC自动化生产线的技术升级等工作，公司在证监会相关政策支持和鼓励下，积极探索使用定向可转换公司债券工具进行配套融资。报告期内，公司完成了收购相关股份和定向可转债的发行和登记工作，并成为深交所首次以定向可转换公司债券完成配套融资的案例。

（二）启动珠海数字化新工厂建设，并加速推动项目工厂建设进程

随着5G时代临近，PCB作为电子信息产业基础性核心部件，将朝着高频高速、高度集成、轻薄化、智能化加速发展，对产品工艺与可靠性要求也将大幅提升，也对生产厂商产出规模、技术成熟度、工艺品质控制能力和综合管理能力提出了更高要求。报告期内，公司积极有序推动珠海项目工厂（1-A期）的建设工作，目前正在开展包含主厂房、办公研发楼、存货仓库、员工宿舍、污水处理中心、员工食堂与宿舍、员工运动场所、室外停车场及园林景观等工程设施建设。新工厂筹备组正以时不我待、只争朝夕的精神投入到了建设工作，该项目预计将于2020年三季度内完成主体厂房的封顶，预计将于2020年四季度内完成二次装修及开始主要设备安装。

（三）紧跟下游新兴应用市场需求，提升工艺水平和研发能力

报告期内，公司紧跟下游新兴应用市场需求，积极围绕5G高频高速板、高阶HDI板、刚柔结合板等领域开展新产品开发和工艺提升工作，并取得了良好成果。目前，在5G高频高速板方面，公司已完成多款多层高速混压板、光模块板、5G天线板、5G升频器高频板的开发与制作；在新型高清显示方面，公司“MiniLED显示封装基板关键技术研发”通过了先进成果评审，芯片级封装灯珠板和高阶HDI MiniLED板已完成批量制作；在高阶HDI方面，公司工艺水平不断提升，10-12层5阶HDI产品陆续完成样品制作；在刚柔结合板方面，公司完成了相关工艺突破，并实现了以HDI为核心的刚柔结合板批量生产和在新产品方面的销售应用。

2019年度公司共开展5G通信高频高速PCB、传感通信高频高速印制电路组件关键技术研究、5G通信LCP多层板盲孔技术、基站用天线板加工技术的研究、OLED显示屏用刚柔一体FPC研发项目、刚柔结合板密集孔钻技术研究、MiniLED封装产品、新能源汽车电池保护板、充电桩用印制电路板（铜基板）工艺技术研究、高多层服务器产品混压技术研究等多项创新项目研发，自主申请专利50项（其中发明专利33项），获得专利授权11项，取得软件著作权6项，发表论文9篇，其中“全自动贴补强机”发明专利荣获第21届中国专利奖优秀奖。报告期内，公司获得全国电子信息行业创新企业、2019年广东省智能制造试点示范项目、广东省LED封装印制电路板工程技术研究中心、广东省民营企业创新产业示范化基地等系列资质和荣誉称号。

（四）积极聚焦和开拓目标市场，产品和客户结构持续优化

报告期内，公司积极围绕企业发展战略，继续加强目标市场与目标客户开拓，快速响应市场与客户需求变化。一方面，公司继续巩固和深化现有客户资源基础，拓宽业务合作范围和深度，公司在LED高清显示领域持续发力，艾比森、光祥科技、视源股份、国星光电、强力巨彩等优质客户订单持续稳定增长，并逐步向小间距LED、MiniLED技术路径深入发展；在通信移动终端领域，公司继续与龙旗、华勤、闻泰、中诺等主流手机ODM企业和品牌手机客户合作持续深化。另一方面，公司产品继续向细分市场优质品牌客户以及高附加值应用集中，持续优化产品与客户结构，提升产品竞争力和抗风险能力。报告期内，公司HDI产品由原来一阶、二阶为主，逐步向二阶、三阶为主转换，产品层阶持续提升；FPC产品由传统的CTP、LCM的应用快速向OLED应用及刚柔结板等新型高附加产品集中，FPC业务利润水平稳步增长；同时，针对5G通信、数据中心与云计算等新兴市场领域，目前正积极进行新产品开发、测试认证，多款产品已向相关客户小批量生产供货。

（五）持续推进管理与组织变革，努力提升企业运营效率

报告期内，公司秉承“公平公正、诚信尽责、以人为本、变革创新”的企业价值观，坚持“改革、创新、高效”的企业精神，在深化管理与组织变革、提升管理与运营效率等方面做了大量工作。报告期内，在公司治理方面，公司设立董事会办公室，并成立了专门委员会下属工作组，强化对战略产品、创新技术、目标市场以及投资并购方向与策略的战略研判与发展定位；在人力资源体系建设方面，公司积极引进业内优秀人才加入、优化绩效考核机制和人才培养体系，提升员工工作积极性和员工满意度，同时公司整合了仓储与物控等职能中心，强化中央整体管控能力；在供应链管理方面，进一步加大垂直整合供应链体系力度，借鉴行业成熟方式方法，建立PCB供应链体系标准，优化制造系统流程，提升库存周转率；在信息化系统建设方面，公司不断升级完善ERP系统，重点推动公司制造与供应链系统的信息化建设，实施车间电子看板、品质管理数字化项目、优化仓储条码管理等项目，提升工厂的数字管控能力和生产效率。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减

刚性电路板（含 HDI 板）	1,427,664,487.77	1,094,160,222.75	23.36%	5.08%	-1.06%	4.76%
柔性板	291,560,792.92	203,185,859.17	30.31%	50.15%	47.41%	1.30%
柔性板组件	348,681,411.14	298,471,514.61	14.40%	84.48%	95.13%	-4.67%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

7、涉及财务报告的相关事项

（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

详见第十二节、五、44 重要会计政策和会计估计变更。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

惠州中京电子科技股份有限公司

2020 年 4 月 8 日